

2014-2019年中国封装用陶瓷外壳市场监测与投资前景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2019年中国封装用陶瓷外壳市场监测与投资前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201407/109811.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

封装用陶瓷外壳指对电子元器件进行封装使用的陶瓷外壳，而保护里面的电子元器件。由于陶瓷具有优良的综合特性，被广泛用于高可靠性微电子封装。陶瓷封装由于它的卓越性能，在航空航天、军事及许多大型计算机方面都有广泛的应用。

随着电子产品各方面性能要求的不断提高，陶瓷封装外壳在高可靠、大功率电子器件中有了很广泛的应用，芯片需要封装外壳在确保机械保护和密封可靠以外，有很好的与外界的导电、导热能力。这就要求陶瓷要能够和不同的金属很好的封接，其中金属化工艺是关键的一道工艺过程。金属化是指在陶瓷上烧结或沉积一层金属，以便陶瓷和金属能高质量的封接在一起。金属化的好坏直接影响到封装的气密性和强度。汽车电子领域使用的陶瓷封装明显增大。沿海发达地区经济，能给企业提供好的融资环境。由于陶瓷封装行业的研发和生产具有较高的技术壁垒，实用产品价格相对比较高，在产品的消费群体上，适合中高收入人群。沿海发达地区经济，消费群体人均收入相对也比较高。

我国金属、陶瓷封装产业发生了很大变化。集成电路快速封装市场已逐步形成，这与我国集成电路设计开发力度的增大和新的圆片工艺线的增加有关，由于国内技术、市场、人才和成本较国外有显著的优势，直接导致国外的金属外壳生产线开始向国内转移。表面安装型的声表、晶振器件用陶瓷或金属外壳大量由外商独资企业在国内生产，并已形成了每年近50亿只的产能。汽车电子领域使用的陶瓷封装明显增大，进步较明显。而我过汽车处于复苏发展阶段，陶瓷封装使用增大将更明显。金属、陶瓷封装产业链也在不断完善，产业规模也在逐渐壮大，其中技术力量相对强的企业增幅比较明显，但还没有产业领头羊的企业出现，也没有形成明显的规模优势。原小型金属外壳的价格优势逐渐被薄型化、微型化、轻量化要求所冲淡，从而一定程度上抑制了金属外壳的增长。

本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内封装用陶瓷外壳行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国封装用陶瓷外壳行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国封装用陶瓷外壳行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是封装用陶瓷外壳行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。

报告目录

第一部分 封装用陶瓷外壳行业运行现状

第一章 封装用陶瓷外壳产品概述

第一节 产品定义

第二节 产品用途

第三节 封装用陶瓷外壳市场特点分析

一、产品特征

二、价格特征

三、渠道特征

四、购买特征

第四节 行业发展周期特征分析

第二章 封装用陶瓷外壳行业环境分析

第一节 中国经济发展环境分析

一、中国GDP分析

二、固定资产投资

三、城镇人员从业状况

四、恩格尔系数分析

五、2014-2019年中国宏观经济发展预测

第二节 中国封装用陶瓷外壳行业政策环境分析

一、产业政策分析

二、相关产业政策影响分析

第三节 中国封装用陶瓷外壳行业技术环境分析

一、中国封装用陶瓷外壳技术发展概况

二、中国封装用陶瓷外壳产品工艺特点或流程

三、中国封装用陶瓷外壳行业技术发展趋势

第二部分 封装用陶瓷外壳市场发展分析

第三章 中国封装用陶瓷外壳市场分析

第一节 封装用陶瓷外壳市场现状分析及预测

一、2012-2013年中国封装用陶瓷外壳市场规模分析

二、2014-2019年中国封装用陶瓷外壳市场规模预测

第二节 封装用陶瓷外壳产品产能分析及预测

一、2012-2013年中国封装用陶瓷外壳产能分析

二、2014-2019年中国封装用陶瓷外壳产能预测

第三节 封装用陶瓷外壳产品产量分析及预测

一、2012-2013年中国封装用陶瓷外壳产量分析

二、2014-2019年中国封装用陶瓷外壳产量预测

第四节 封装用陶瓷外壳市场需求分析及预测

一、2012-2013年中国封装用陶瓷外壳市场需求分析

二、2014-2019年中国封装用陶瓷外壳市场需求预测

第五节 封装用陶瓷外壳进出口数据分析

一、2012-2013年中国封装用陶瓷外壳进出口数据分析

二、2014-2019年国内封装用陶瓷外壳产品未来进出口情况预测

第四章 封装用陶瓷外壳细分行业分析

第一节 IC陶瓷封装分析

第二节 芯片陶瓷封装分析

第五章 封装用陶瓷外壳产业渠道分析

第一节 2013年国内封装用陶瓷外壳产品的需求地域分布结构

第二节 2012-2013年中国封装用陶瓷外壳产品重点区域市场消费情况分析

一、华东

二、中南

三、华北

四、西部

第三节 2013年国内封装用陶瓷外壳产品的经销模式

第四节 渠道格局

第五节 渠道形式

第六节 渠道要素对比

第七节 封装用陶瓷外壳行业国际化营销模式分析

第八节 2013年国内封装用陶瓷外壳产品生产及销售投资运作模式分析

一、国内生产企业投资运作模式

二、国内营销企业投资运作模式

三、外销与内销优势分析

第三部分 封装用陶瓷外壳竞争市场分析

第六章 企业分析可由客户指定企业

第一节 长电科技

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力分析
- 六、企业偿债能力分析
- 七、企业竞争优势分析
- 八、企业发展战略分析

第二节 中芯国际

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业经营能力分析
- 四、企业盈利指标分析分析
- 五、企业财务以及流动性指标分析

第三节 湖北台基半导体股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力分析
- 六、企业偿债能力分析
- 七、企业发展战略分析

第四节 台积电

- 一、企业概况
- 二、企业估值指标分析
- 三、企业财务以及流动性指标分析
- 四、企业盈利能力分析

第五节 浙江中宙光电股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业竞争优势
- 三、企业发展战略

第六节 深圳市瑞丰光电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业竞争优势分析

三、企业发展战略分析

第七节 深圳市晶台股份有限公司

一、企业概况

二、企业规模

三、企业发展战略

第八节 深圳市璨阳光电有限公司

第七章 封装用陶瓷外壳行业相关产业分析

第一节 封装用陶瓷外壳行业产业链概述

第二节 封装用陶瓷外壳上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

二、上游原材料需求情况分析

第三节 封装用陶瓷外壳下游行业发展情况分析

第四部分 封装用陶瓷外壳行业发展前景分析

第八章 2014-2019年封装用陶瓷外壳行业前景展望与趋势预测

第一节 封装用陶瓷外壳行业投资价值分析

一、2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业盈利能力分析

二、2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业偿债能力分析

三、2014-2019年国内封装用陶瓷外壳产品投资收益率分析预测

四、2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业运营效率分析

第二节 2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业投资机会分析

一、国内强劲的经济增长对封装用陶瓷外壳行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对封装用陶瓷外壳行业的推动因素分析

三、封装用陶瓷外壳产品相关产业的发展对封装用陶瓷外壳行业的带动因素分析

第三节 2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业投资热点及未来投资方向分析

一、产品发展趋势

二、价格变化趋势

三、用户需求结构趋势

第四节 2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业未来市场发展前景预测

一、市场规模预测分析

二、市场结构预测分析

三、市场供需情况预测

第九章 2014-2019年封装用陶瓷外壳行业投资战略研究

第一节 2014-2019年中国封装用陶瓷外壳行业发展的关键要素

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第二节 2014-2019年中国封装用陶瓷外壳投资机会分析

一、封装用陶瓷外壳行业投资前景

二、封装用陶瓷外壳行业投资热点

三、封装用陶瓷外壳行业投资区域

四、封装用陶瓷外壳行业投资吸引力分析

第三节 2014-2019年中国封装用陶瓷外壳投资风险分析

一、技术风险分析

二、原材料风险分析

三、政策/体制风险分析

四、进入/退出风险分析

五、经营管理风险分析

第四节 对封装用陶瓷外壳项目的投资建议

一、目标群体建议（应用领域）

二、产品分类与定位建议

三、价格定位建议

四、技术应用建议

五、销售渠道建议

六、资本并购重组运作模式建议

七、企业经营管理建议

八、重点客户建设建议

图表目录

图表：2008-2013年中国GDP及增长率

图表：2008-2013年中国人均GDP及增长率

图表：2013年固定资产投资到位资金情况

图表：2010-2013年中国固定资产投资及增长

图表：2014年1-3月份全国固定资产投资

图表：2014年1-3月固定资产投资到位资金增速

图表：2013-2014年中国固定资产投资

图表：2007-2013年中国恩格尔系数

图表：热导率随Al₂O₃含量的变化

图表：几种陶瓷基片材料的性能

图表：陶瓷金属化膏印刷图

图表：封装陶瓷典型烧结过程的温度、时间图。

图表：紫外引发聚合流延成型工艺流程图

图表：凝胶注模工艺流程图

图表：2012-2013年中国封装用陶瓷外壳市场规模

图表：2014-2019年中国封装用陶瓷外壳市场规模预测

图表：2012-2013年中国封装用陶瓷外壳产能

图表：2014-2019年中国封装用陶瓷外壳产能预测

图表：2012-2013年中国封装用陶瓷外壳产量

图表：2014-2019年中国封装用陶瓷外壳产量预测

图表：2012-2013年中国封装用陶瓷外壳市场需求

图表：2014-2019年中国封装用陶瓷外壳需求预测

图表：2012-2013年中国封装用陶瓷外壳进口额

图表：2012-2013年中国封装用陶瓷外壳出口额

图表：2014-2019年中国封装用陶瓷外壳进口额预测

图表：2014-2019年中国封装用陶瓷外壳出口额预测

图表：2013中国陶瓷封装地区结构

图表：生产型企业运营图

图表：2013年主营产品产销量

图表：2013年企业封装业务成本构成

图表：2013年企业封装业务费用构成

图表：2013-2014年长电科技主要经济指标分析

图表：2013-2014年长电科技成长性分析

图表：2013-2014年长电科技运营能力分析

图表：2013-2014年长电科技盈利能力分析

图表：2013-2014年长电科技偿债能力分析

图表：2012-2013年中芯国际主要经济指标分析

图表：2012-2013年中芯国际经营能力分析
图表：2012-2013年中芯国际盈利能力分析
图表：2012-2013年中芯国际财务以及流动性指标分析
图表：2013-2014年台基股份主要经济指标分析
图表：2013-2014年台基股份成长力分析
图表：2013-2014年台基股份经营力分析
图表：2013-2014年台基股份盈利力分析
图表：2013-2014年台基股份偿债力分析
图表：2013年台积电公司估值指标分析
图表：2013年台积电公司财务以及流动性指标分析
图表：2013年台积电公司盈利指标分析
图表：2013-2014年全球氧化铝产量分析
图表：2013-2014年我国氧化铝表观消费量
图表：2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业盈利能力预测
图表：2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业偿债能力预测
图表：2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业投资收益率预测
图表：2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业运营效率预测
图表：2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业市场规模增长预测
图表：2014-2019年国内封装用陶瓷外壳行业供需预测

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201407/109811.html>